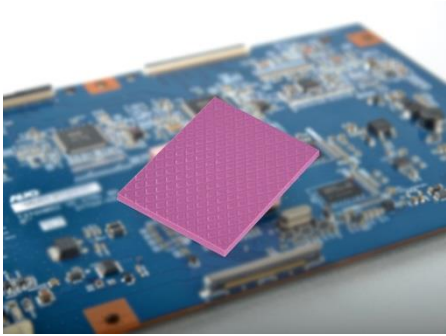


# TP400 高性能导热硅胶垫片

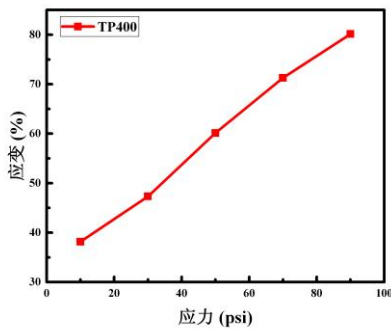
## 特性和优点

- 导热系数: 4.0 W/m.K
- 低压缩力应用 · 具有高压缩比
- 双面自粘
- 低出油
- 高电气绝缘
- 良好耐高温性能
- 兼具高散热性能与成本效益

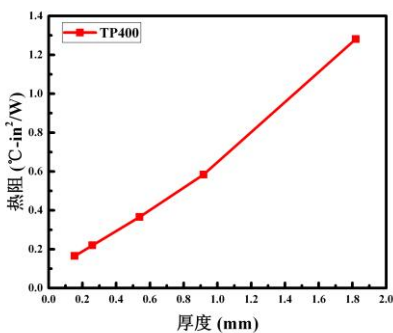


TP400导热硅胶片是一款高导热性能的材料,双面自粘,与电子组件装配使用时,低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。在-40°C~200°C可以稳定工作,满足UL94V0的阻燃等级要求。

形变量与压力关系图



厚度与热阻性



## TP 400 的典型属性

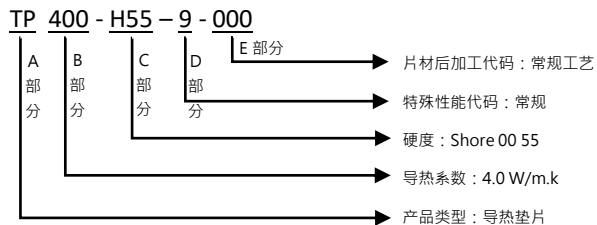
属性	公制值	测试方法
组成部分	硅胶/陶瓷	-
颜色	紫色	目视
厚度(mm)	0.5~6.5	ASTM D374
密度 (g/cc)	3.2	ASTM D792
硬度 (Shore OO)	55	ASTM D2240
长期使用温度 (°C)	-40~200	-
<b>电性能</b>		
击穿电压 (Kv/mm)	>6.0	ASTM D149
介电常数 (@10MHz)	7.5	ASTM D150
体积电阻率 (Ω.cm)	10 <sup>10</sup>	ASTM D257
防火性能	V-0	UL 94
<b>热性能</b>		
导热系数 (W/m.K)	4.0	ASTM D5470

\*厚度 $T \leq 0.75$  mm, 硬度 $H = \text{Shore OO } 60$

## 典型应用

- 笔记本和台式计算机
- 显卡散热模块
- 高导热需求的模块
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 硬盘驱动和DVD驱动
- LCD背光模块 & 网络通信设备

## 产品编码规则



标准尺寸:  $T \leq 1.5$ mm · 尺寸=200x400mm ;  $T > 1.5$ mm · 尺寸=150\*150. 可依客户指定模切成各种尺寸或形状。厚度按照0.25mm递增。